## Ag 誘起層交換による p/n 型 Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>熱電薄膜の合成

p- and n-type Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub> thermoelectric thin films formed by Ag-induced layer exchange <sup>O</sup>辻美紀江<sup>1</sup>, 村田正行<sup>2</sup>, 山本淳<sup>2</sup>, 末益崇<sup>1</sup>, 都甲薫<sup>1,3</sup>

(1. 筑波大院 数理物質, 2. 産総研, 3. JST さきがけ)

°Mikie Tsuji<sup>1</sup>, Masayuki Murata<sup>2</sup>, Atsushi Yamamoto<sup>2</sup>, Takashi Suemasu<sup>1</sup>, and Kaoru Toko<sup>1,3</sup>

(1. Univ. of Tsukuba, 2. AIST, 3. JST PRESTO)

E-mail: s1920329@s.tsukuba.ac.jp

【はじめに】SiGe 混晶は、宇宙用の熱電変換 素子として高い実績を持つ. 我々は Al や Zn を 触媒とした「層交換」を用いることで、p型 SiGe 熱電薄膜を低温合成してきた [1,2]. 一方、触 媒金属にあらかじめ不純物を添加しておくこと で、層交換後のSiGe 膜中に不純物が自己組織 的にドーピングされ、熱電性能が向上することを 明らかにしてきた [3]. 今回、SiGe に対してドー パントとならない Ag を用い、SiGe の Ag 誘起層 交換を初めて検討した. さらに、不純物添加に よる p/n型 SiGe 熱電薄膜の合成に成功する とともに、熱電デバイス動作を実証したので報 告する.

【実験方法】 石英ガラス上に Ag, AgB(B 濃度: 10%)および AgAs(As 濃度: 10%)層を 50 nm 堆積した. その後, 非晶質 Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>(x: 0, 0.15, 0.3)層を 50 nm 堆積し, N<sub>2</sub> 雰囲気で熱処理 (500 ℃, 15 h)を施すことで, 層交換を誘起した (Fig. 1). 堆積にはスパッタリング法を用いた. 層交換後の試料について, 上部 Ag 層をリン硝 酢酸で除去した.

【結果・考察】作製した全試料において,低温 (≤ 500 ℃)で層交換が発現し,多結晶 SiGe 層



Fig. 4. Thermoelectric *I-V* and *I-P* curves of TEG at RT.

の形成が確認された(Fig. 2(a)). また EBSD 評価から,得られた SiGe 層は小粒径(<3  $\mu$ m)であることが 判明した(Fig. 2(b)). 高い熱抵抗が期待される. ホール効果測定から, AgB を用いた試料では p 型伝 導, AgAs を用いた試料では n 型伝導を示した(Fig. 3(a)). x 増加に伴う正孔密度と電子密度の減少は, SiGe 中の B および As 固溶限の減少を反映していると考えられる. 導電率の挙動は,キャリア密度と結晶 粒径を反映している(Fig. 3(b)). p 型膜については正, n 型膜については負のゼーベック係数が得られ, 測定温度とともに増大した(Fig. 3(c)). また,その大きさはキャリア密度と SiGe 混晶の基礎物性に従う傾 向を示した. 室温での出力因子は, n 型で 1000  $\mu$ W/mK<sup>2</sup>(Si<sub>0.85</sub>Ge<sub>0.15</sub>), p 型で 230  $\mu$ W/mK<sup>2</sup>(Si) に及び, 高い熱電特性が得られた(Fig. 3(d)). さらに,本手法で得られた p 型および n 型 SiGe 薄膜を用いて TEG を作製し(Fig. 4(a)),出力測定を行ったところ,室温,温度差 10 K において 0.15 nW の出力が得 られた(Fig. 4(b)). 測定構造の最適化や厚膜化によって,さらなる出力の向上が見込まれる.

[1] K. Kusano *et al.*, ACS Appl. Energy Mater. 1, 5280 (2018). [2] K. Kusano *et al.*, APEX. 12, 055501 (2019).
[3] M. Tsuji *et al.*, J. Phys. D. 53, 075105 (2020)